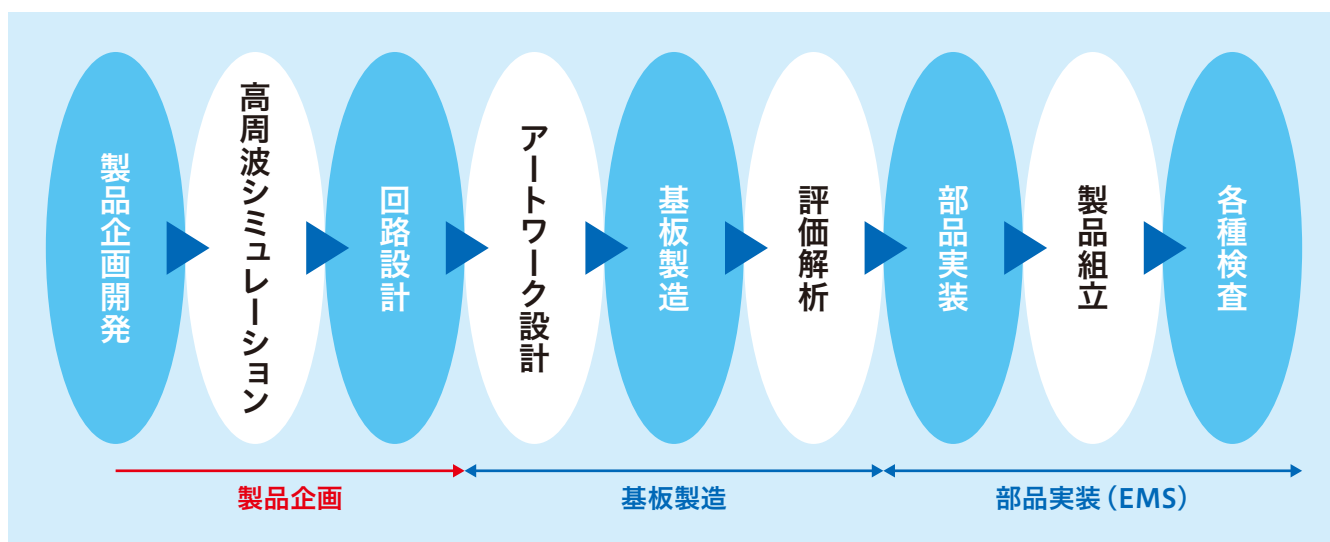


新規開発品

ワンストップサービス+αへ

お客様の創造を製品企画開発から製品化まで！

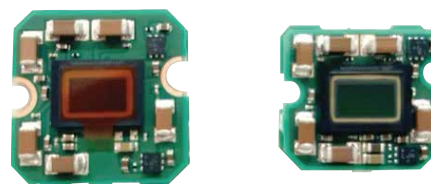


カメラモジュール小型化へのアプローチ

既存のカメラ基板に対し、新技術を適用し小型化（サイズ30%減）へ

- 配線の高密度化
- 部品内蔵化
- 回路設計からモジュール化まで一貫対応可能

更なる小型化を目指し、開発を進めていきます。



透明ディスプレイへのアプローチ

背景視野を阻害しない透明性の実現へ

- 透過性の良い基材
- 実装可能な基材
- 両面配線対応

微細配線化など、より意匠性の高い開発を進めていきます。

